



2025 年 8 月 8 日

各位

[illegible]

大手半導体関連メーカーより大口受注のお知らせ

当社は、海外の大手半導体関連メーカー2社より、PLP（パネルレベルパッケージ）向けパネルハンドリングシステムを受注いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 今回の受注について

半導体製造工程においては、A I用などの先端半導体市場拡大を背景とする高性能・高機能化ニーズに対応するため、チップレット集積、パッケージの大型化が求められています。その中、半導体の生産性を上げるプロセスとして、P L P採用の検討及び開発が本格化しております。当該システムは、パネルの薄化・積層化に対し重要なプロセスを担っています。

当社は、WLP（ウエハレベルパッケージ）向けウエハハンドリングシステムの生産実績に加え、長年培ってきたボンディング・剥離及び洗浄プロセスにモノづくり力を融合した、高性能なパネルハンドリングシステムを提案して参りました。その結果、これまでの取引実績も踏まえ、安定した品質と歩留まり向上を実現できる点が評価され、今般の受注に至りました。

2. 受注内容

受注製品	パネルハンドリングシステム（ボンダー・デボンダー装置）
受注金額	約 25 億円
売上計上予定	2026 年 6 月期、2027 年 6 月期

3. 業績への影響

当該受注は、今期（2026 年 6 月期）と 2027 年 6 月期に売上計上する見込みです。なお、今期計上見込みの売上は、2025 年 8 月 8 日公表の 2026 年 6 月期の連結業績予想に織り込まれています。顧客との納期調整等により、今期業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。

なお、当該受注はすべて円建てとなっており、為替レートの変動による影響はありません。

以上